

LCP 日本新石油化学HM-302连接器专用LCP塑胶原料详情

产品名称	LCP 日本新石油化学HM-302连接器专用LCP塑胶原料详情
公司名称	浩正新材料科技（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	赛钢POM:连接器专用LCP塑胶原料 PFA铁氟龙:光学镜头COC材料 COC材料:PFA铁氟龙粒子粉末
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶路1号55号楼106室
联系电话	18825708836 13794983753

产品详情

由于拥有的粘合持久性和食品卫生性，在食品包装领域赢得了广大客户的信赖。由于引入的官能团的作用，针对聚烯烃的颜料、木粉等多种填料，Admer也可以起到偶联剂的效果，增加这些填料与聚烯烃的相容性。

具有良好的耐辐射照性和化学稳定性，故常用于原子能工业密封材料和仪表零部件。它可加工成形状复杂的制品，薄而口径大的管、薄片、薄膜、电线包皮、热收缩管和化工设备衬里等。

医疗器械：可在134℃下经受3000次循环高压灭菌，这一特性能满足灭菌要求高、需反复使用的手术和牙科设备的制造，加上它的抗蠕变和耐水解性，用它可制造需高温蒸汽消毒的各种医疗器械。尤为重要是PEEK无毒、质轻、耐腐蚀，是与人体骨骼最接近的材料，因此可采用PEEK代替金属制造人体骨骼。

工业领域：由于具有良好机械性能、耐高温、耐磨耗，并能耐高压，常用来制造压缩机阀片、活塞环、密封件等。

塑胶原料按照合成树脂的分子结构分主要有热塑性及热固性塑胶之分：对于热塑性塑胶指反复加热仍有可塑性的塑胶：主要有PE/PP/PVC/PS/ABS/PMMA/POM/PC/PA等常用原料。热固性塑胶主要指加热硬化的合成树脂制得的得塑胶，像一些酚醛塑胶及氨基塑胶。

改性聚醚醚酮有黑色碳纤增强导电聚醚醚酮、红色碳纤增强导电聚醚醚酮、有矿物增强聚醚醚酮、有玻纤增强聚醚醚酮及PEEK树脂。虽然聚醚醚酮具有许多优良性能，但是价格昂贵，限制了其在一些领域的应用。另外，它的冲击强度较差，为了进一步提高其性能，以满足各个领域的综合性能和多样化需要，可采用填充、共混、交联、接枝等方法对其进行改性，以得到性能更加优异的PEEK塑料合金或PEEK复合材料。例如：PEEK与聚醚共混可得到更好的力学性能和阻燃性；PEEK与PTFE共混制成复合材料，具有突出的耐磨性，可用于制造滑动轴承、动密封环等零部件；PEEK用碳纤维等填充改性，制成增强的PEEK复合材料，可大大提高材料的硬度、刚性及尺寸的稳定性等。

POM塑胶原料系列可注塑成型，挤出成型，压缩成型，滚塑成型，吹塑成型。应用于齿轮，链轮，滑轮，滑轨，弹簧，支架，卫浴，阀门，导轨，剃须刀，水，夹子，电动牙刷，插座，开关零件，燃油系统部件，玩具，洗衣机，轴承，工具把手，密封垫，淋浴喷头，外壳，座椅安全带扣，拉链，卡扣，纽扣，板材，杆，板料，结构部件和机加工。

很不耐酸，不耐强碱和不耐紫外线的辐射。(加入UV剂，能大大提高其耐紫外线等级)

它的耐磨性和自润滑性也比绝大多数工程塑料优越，又有良好的耐油，耐过氧化物性能。

新型工程塑料，可用作耐高温结构材料和电绝缘材料，可与玻璃纤维或碳纤维复合制备增强材料。

POM具有明显的熔点，均聚POM为175、共聚POM为165。成型时，料筒温度的分布：前段190~200，中段180~190，后段150~180，喷嘴温度为170~180。对于薄壁制品，料筒温度可适当提高些，但不能超过210

一般热致性液晶聚合物具有较好的流动性，易加工成型。其成型产品具有液晶聚合物特有的皮芯结构，树脂本身具有纤维性质，在熔融状态下有高度的取向，故可起到纤维增强的效果。这也是液晶聚合物引人注目的特点。

有些塑胶原料会吸湿,并引起尺寸和性能变化;

特种塑胶原料 这类塑胶原料具有独特的功能，可用于一些特殊场合，如导磁塑料、离子体塑料、珠光塑料、光敏塑料、医用塑料等。

LCP塑胶原料的特性；

- a、LCP具有自增强性：具有异常规整的纤维状结构特点，因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平。如果用玻璃纤维、碳纤维等增强，更远远超过其他工程塑料。
- b、液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性，对大多数塑料存在的蠕变特点，液晶材料可以忽略不计，而且耐磨、减磨性均优异。
- c、LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有优异的阻燃性，能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。
- d、LCP具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高，耐电弧性良好。在连续使用温度200-300，其电性能不受影响。间断使用温度可达316左右。
- e、LCP具有突出的耐腐蚀性能，LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀，对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，接触后不会被溶解，也不会引起应力开裂。

LCP塑胶原料的应用

- a、电子电气是LCP的主要市场：电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要求（能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接）。
- b、LCP：印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面。
- c、LCP加入高填充剂或合金（PSF/PBT/PA）作为集成电路封装材料、代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料；作光纤电缆接头护套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料。代替玻璃纤维增强的

聚砜等塑料（宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统）。